

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**Gniazda PCB Ethernetu jednoparowego**

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.

Zalety jednoparowego Ethernetu:

- Stabilność: jednoparowy Ethernet umożliwia standardową komunikację Ethernet od czujnika do chmury
- Potencjał rozwojowy: kluczowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz IIoT
- Uniwersalność: zakres do 1000 m i prędkość do 1 Gbps umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach
- Innowacyjność: niska masa, mała wielkość i łatwa instalacja

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, Wkładka M8 PCB, złącze żeńskie, Połączenie lutowane, Styk męski, IP67 z obudową, Połączenie lutowane THT/THR, 180°, Liczba biegunów: 2
Nr zam.	2735920000
Typ	IE-PCB-SPM-P-180-THR
GTIN (EAN)	4050118820164
Ilość	100 Szt.

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	14,5 mm	Głębokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0,945 inch
Szerokość	10,1 mm	Szerokość (cale)	0,398 inch
Masa netto	3 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
----------------------------	----------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 63171-5
--------------------------------	-------------

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	4 A	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	2250 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC
napięcie znamionowe	72 V		

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	≥ 100	Kategoria	T1-B
Klasa mocy	T1-B	Liczba biegunów	2
Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny, Lutowa- nie falowe	Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane, Styk męski
Rodzina produktów	Industrial Ethernet	Stopień ochrony	IP67 z obudową
kąt odejścia	180°	montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/ THR

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	Ni/Au
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C

Opakowanie

Długość VPE	330 mm	Szerokość VPE	330 mm
Wysokość VPE	49 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Katalogi

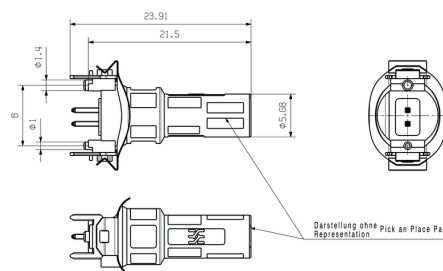
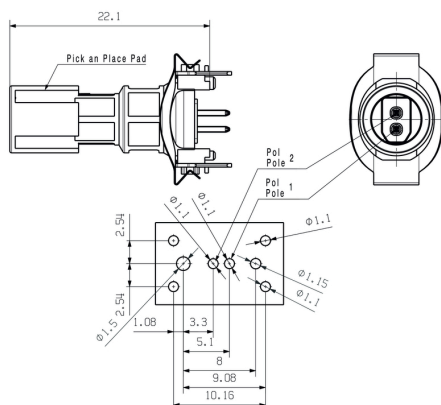
[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C . In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.